

Pouzdra integrovaných obvodů (Integrated Circuit)

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslerova

Autor: Ing. Pavel Votrubec

Název: VY_32_INOVACE_02_CIT_26_Pouzdra_IO

Téma: Pouzdra Integrovaných obvodů

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



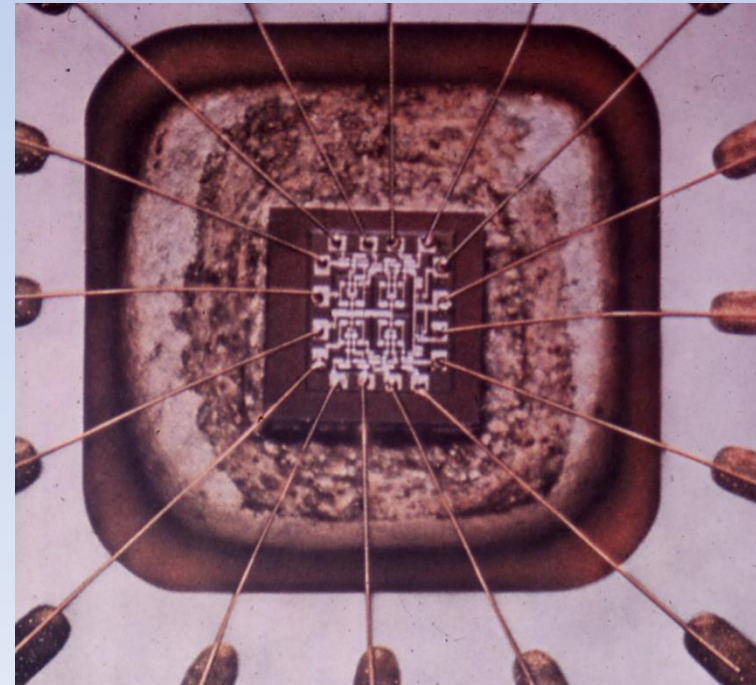
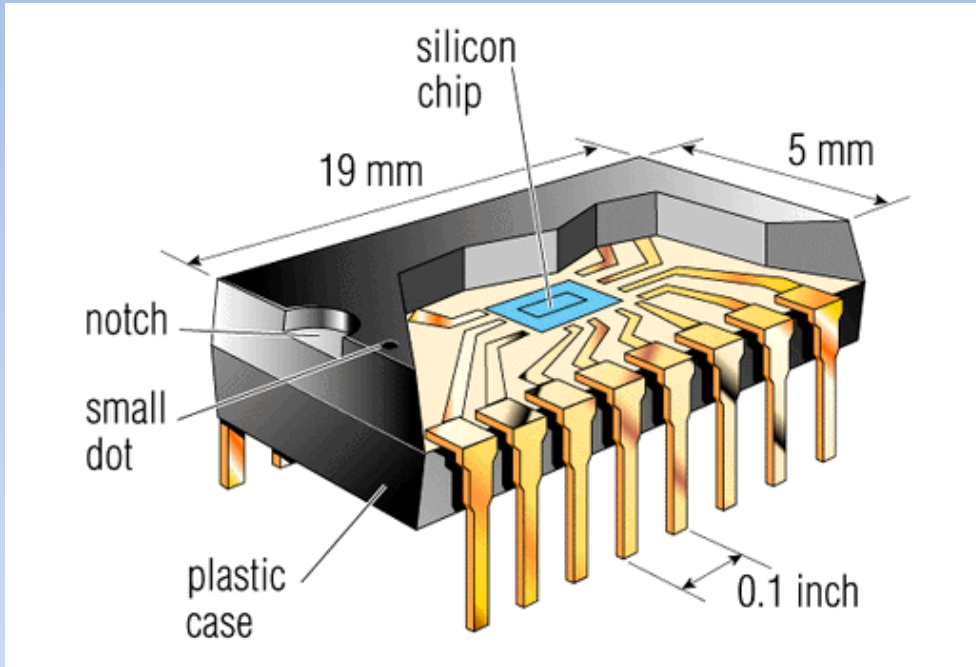
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdelávání
pro konkurenceschopnost

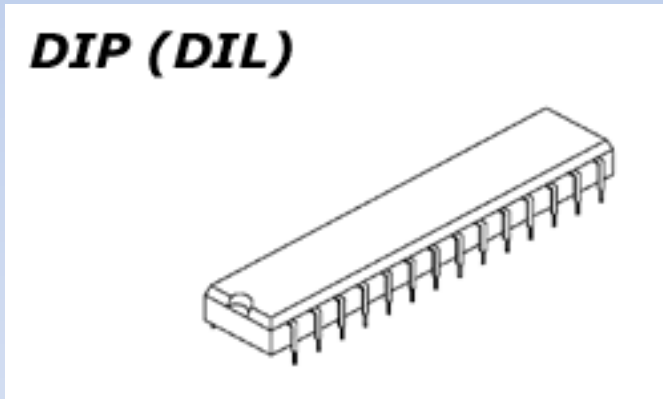
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pouzdra integrovaných obvodů (Integrated Circuit)









Pouzdra IO

- **DIL/DIP (Dual In-Line Package)** z plastu nebo keramického materiálu s vývody na delších stranách. Vývody procházejí skrz díry na plošném spoji. U firmy Ti u tohoto typu pouzdra písmeno na konci označení obvodu značí typ pouzdra (počet nožiček - PINů).



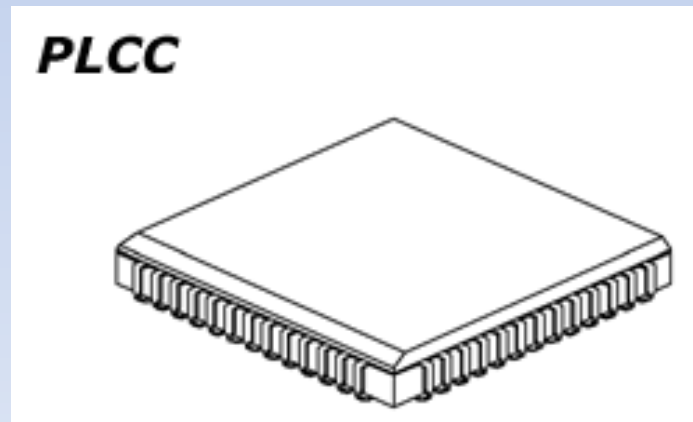
Zdroj: Jan Řehák: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002

Pin	PDIP
8	 P
14	
16	 N  NE
18	 N
20	 N
24	 NT

Zdroj: <http://www.ti.com/lit/sg/sdyu001z/sdyu001z.pdf>

Pouzdra IO

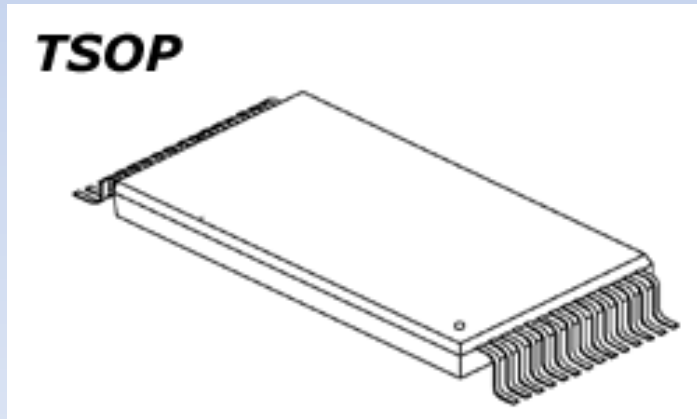
- **PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)**. Výhodou je že lze obvod v PLCC pouzdru umístit do patice i na desku klasické montáže. Vyrábí se i patice pro povrchovou montáž.








Zdroj: Jan Řehák: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002

Pouzdra IO

- Pouzdro pro povrchovou montáž **TSOP (Thin Small Outline Package)**



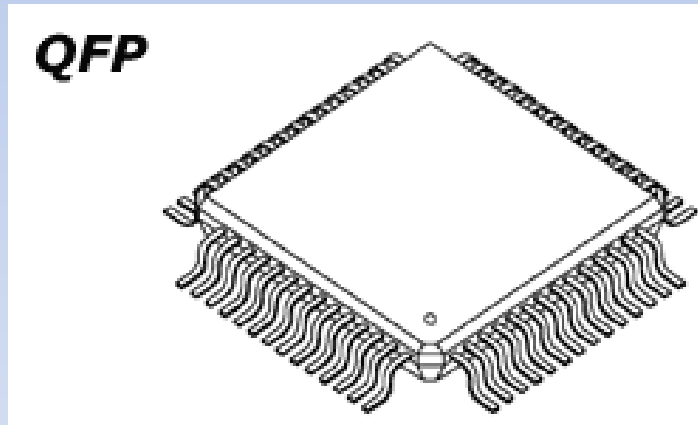
Zdroj: Jan Řehák: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002

Pin	SOP
8	 PS
14	 NS
16	 NS
18	
20	 NS
24	 NS

Zdroj: <http://www.ti.com/lit/sg/sdyu001z/sdyu001z.pdf>

Pouzdra IO

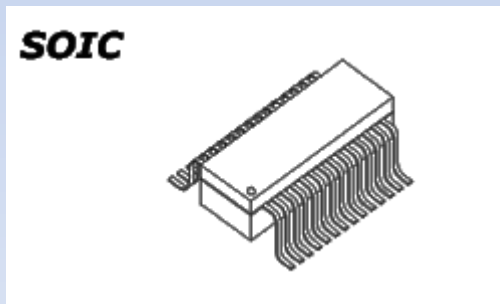
- **QFP (Quad Flat Pack)**, pouzdro pro povrchovou montáž



Zdroj: Jan Řehák: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002

Pouzdra IO

- Pouzdro pro povrchovou montáž **SOIC (Small Outline IC)**, různá je délka pinů, výška pouzdra, rozteče atd.. Pouzdro je celkem standardní, podstatný je výrobce a hlavně kód pouzdra
- **SSOP** (Shrunk Small Outline Package)
- **TSSOP** (Thin Shrunk Small Outline Package)



Zdroj: Jan Řehák: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002

Zdroj: <http://www.ti.com/lit/sg/sdyu001z/sdyu001z.pdf>

Pin	SSOP	TSSOP
8	 DCT	 PW
14	 DB	 PW
16	 DB	 PW
18		
20	 DB	 PW
24	 DB	 PW
28	 DB	 PW
	 DL	
38		 DBT
48	 DL	 DGG
56	 DL	 DGG